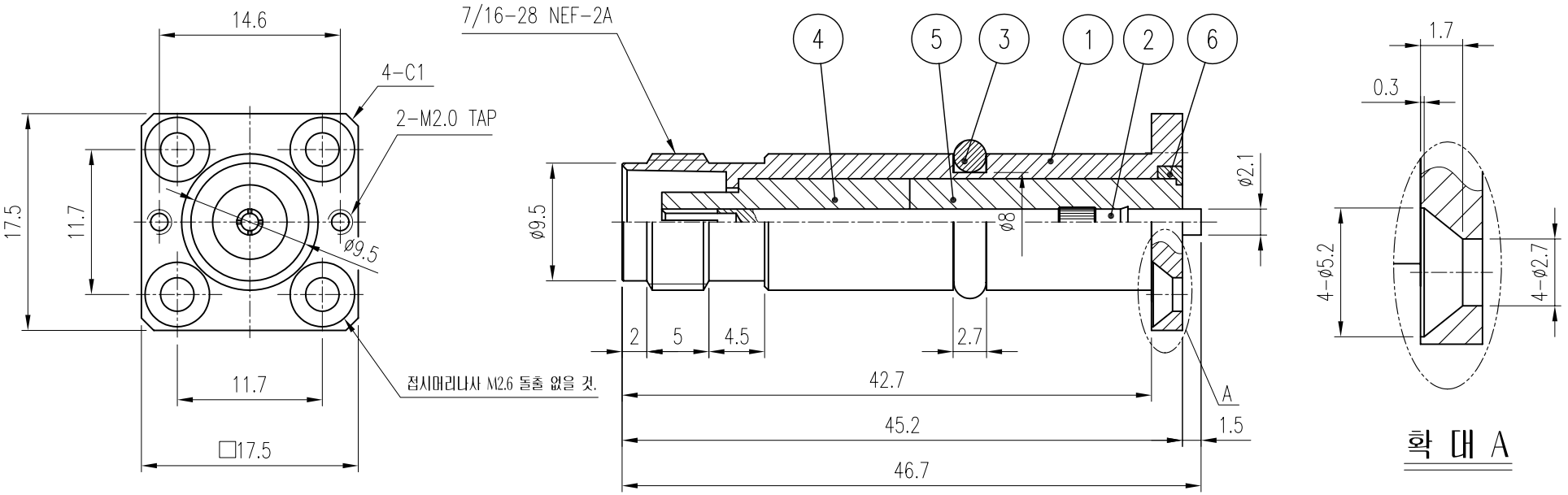
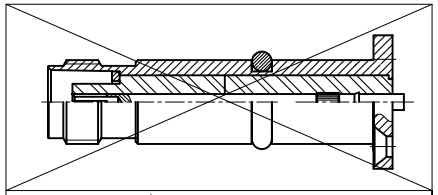
| 기공 / ST | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| ST(기존) | | | | | | | | | | |
| ST(개선) | | | | | | | | | | |

## 수 정 내 용

| 부호 | 내 용 | 수정자 | 승인자 | 년 월 일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소립정 형상[설변No.연구2007-151] ( 고정링 억지끼움 변경 ) | 김은희 | 윤상진 | 2007. 10. 2. |
| | | | | |




| 품번 | 품 명 | 수량 | 재 질 | 표면처리 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 고정 RING | 1 | MBsBD | Gold Plate | DCV00050-5/1 ( L7014 ) ~~L7011~~ |
| 5 | INSULATOR | 1 | TEFLON | | DIN01235-N/1 ( H7095 ) |
| 4 | INSULATOR | 1 | TEFLON | | DIN01234-N/1 ( H7094 ) |
| 3 | GASKET | 1 | SILICONE RUB | AN-109 | DGK00165-N/1 ( G7015 ) |
| 2 | CONTACT | 1 | BeCu | Gold Plate | DCT01451-5/1 ( E7087 ) |
| 1 | BODY | 1 | MBsBD | Gold Plate | DBD01881-5/2 ( D7128 ) |



1 설변 전(VER.0)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

| | | | |
|---|---|---|---|
| 년월일 | 2007. 9. 7. | | |
| 승인 | Y. S. J. | | |
| 검도 | K. I. C. | | |
| 제도 | K. E. H. | | |
| 작성부서 | 연 구 소 | | |
| 척도 2/1 | 단위 mm | 중량 | |

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 TNC-J-H4-R VER.1

A4

도번 CN01520-7/1

K335-457-002